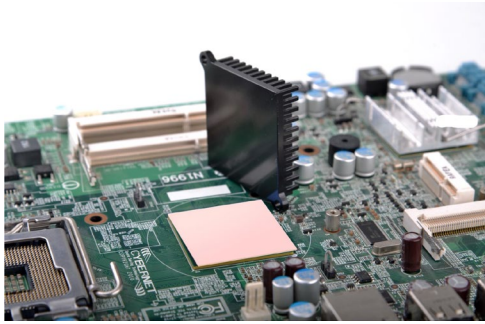


低挥发导热硅胶片

TP300-H30-L是一款低挥发导热垫片，使用硅胶与导热陶瓷填料经由特殊工艺加工而成，双面自粘，低压缩力下表现出良好的导热性能和电气绝缘性能，在-40℃~200℃可以稳定工作，满足UL94 V-0的阻燃等级要求。



特性和优点

- 导热系数3.0W/(m·K)
- 低压缩力应用
- 双面自粘
- 高电气绝缘
- 良好耐温性能
- 低挥发
- 容易装配可重复使用

典型应用

- 安防设备
- 光模块等光学应用
- 网络通讯设备
- 高速大存储驱动
- 汽车发动机控制单元

典型属性		
属性	典型值	测试方法
颜色	浅红色	目视
厚度 (mm)	1.0~6.5	ASTM D374
密度 (g/cc)	3.0	ASTM D792
硬度 (Shore 00)	30	ASTM D2240
挥发冷凝物含量	无挥发冷凝物	玻璃瓶烘烤180°C/8h,目测
重量损失 (% @150°C)	<0.1	ASTM E595-07
低分子硅氧烷含量D3~D10 (ppm)	≤50	/
耐温范围 (°C)	-40~200	/
防火性能	V-0	UL 94
保质期 (月)	12	温度<40°C避免挤压、暴晒
电性能		
击穿电压 (kV/mm)	≥6.0	ASTM D149
体积电阻率 (Ω·cm)	10 ¹³	ASTM D257
介电常数 (@1MHz)	5.72	ASTM D150
导热性能		
导热系数 (W/(m·K))	3.0	ISO 22007-02
热阻 (°C·in ² /W @20psi,1.0mm)	0.3	ASTM D5470